PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-208862

(43)Date of publication of application: 17.09.1986

(51)Int.CL

(21)Application number : 60+050865

(71)Applicant : SANYO ELECTRIC CO LTD

TOKYO SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

14.03.1985

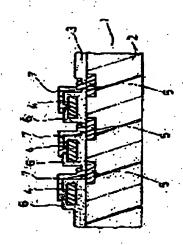
(72)Inventor: NOZAKI TSUTOMU

TANAKA TADAHIKO

(54) SEMICONDUCTOR RESISTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable arbitrary setting of a temperature coefficient as a whole, by implanting ions in first resistive elements formed of polysilicon and second resistive elements formed of ion-implanted layers. CONSTITUTION: The resistive device is constructed of an insulating film 3 of silicon oxide or the like formed on a semiconductor substrate 2 by a thermal oxidation method or the like, first resistive elements 4 formed of polysilicon, having a negative temperature coefficient and patterned on the insulating film 3, second resistive elements 5 having a positive temperature coefficient, formed between the first resistive elements 4 and separated therefrom by the insulating film 3 on the semiconductor substrate 2, insulating films 6 integrated with the insulating film 3 on the semiconductor substrate 2 and covering the respective surface of the first resistive elements 4, and electrodes 7 each connecting the first resistive element 4 and the second resistive element 5 in series. The first resistive element 4 is



formed of polysilicon and has a negative temperature coefficient, while the second resistive element 5 is formed of a P-type ion-implanted layer and has a positive temperature coefficient. By implanting ions in the group of the first resistive elements 4...4 and the group of the second resistive elements 5...5, the temperature coefficient of the first resistive elements 4 or the second resistive elements 5 is changed. According to this constitution, it is made possible to conduct adjustment so that a specified temperature coefficient can be set as a whole.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of ... rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

Best Available Copy

母日本国特許庁(JP)

①特許出顧公開

母公開特許公報(A)

昭61-208862

⊕Int. a,•

識別記号

厅内整理备号

❷公開 昭和61年(1986)9月17日

H 01 L 27/04

P-7514-5F

審査請求 朱請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

半導体抵抗茲置

❷特 顧 昭60-60865

色出 顧 昭60(1985)3月14日

@A型 明 者 野 ■

金 群馬県邑楽郡大泉町大字坂田180番地 東京三洋電像株式

砂 発 明 者 田 中 忠 彦

群馬県邑楽郡大泉町大字板田180番地 東京三洋電機株式

会社内

会社内

の出 顕 人 三洋電機株式会社

守口市京阪本通2丁目18番地

切出 闡 人 東京三洋電機株式会社

群馬県邑英郡大泉町大字坂田180番地

20代 理 人 升强士 佐野 静夫

F A C

- 1. 集頭の水盤 単進化経験政務
- 2. 存許請求の意思

(1) 一等電型の半導体部級と数半導体器板化形成されたギリシリコンより成る第1抵抗体群と約配半導体器型上の過量膜により過配額1抵抗体群と分離された第2抵抗体が突点配置された半導体数量に決立。前配第1抵抗体が負の温度保力を有し、前配第2抵抗体が近の温度保力を有能第1抵抗体群なよび前配第2抵抗体群とは前配第2抵抗体界となっ。直接低分を変化させ、前配第1抵抗体群と対抗体の温度保力を受化させ、前配第1抵抗体群と対抗体の温度保力を受化させ、前配第1抵抗体群としては特定の温度保力を持つ半導体抵抗安全。

3. 発明の評細な説明

(イ) 産業上の利用分野

本発明は半導体果積回路 C用いられ特に量武係 数を任念に設定できる半導体抵抗災星に関するも のである。

何 従来の技術

一般に複数回路に用いられる抵抗体にはペースまたはエミッタ拡張によって作られる拡散抵抗、 エピタキシャル層をそのまま利用したエピタキシャル層をそのまま利用したエピタキシャル層をそのまま利用したエピタキシャル紙抗、ピンテ抵抗、ポリジリコンを用いたポリションを扱うがつきません。これらの抵抗体を利用して高抵抗の抵抗体形成が必要に加る場合がある。

この場合一般には抵抗体を長くするなどして高 抵抗を得るため、抵抗体の占める関数が大きか。 たり抵抗値変数が大きかったりする欠点を有して いた。

上述の欠点を無くするのとして毎関昭59-19368号公輔が詳しく、一等電型の半導体器 根上に熱酸化等で形成した酸化酸と酸酸化酸上に 形成したポリシリコンより成る第1級飲体群と前 配半導体器板上の絶象膜により前配第1級飲体群と前 と分膜しかつ解1級放体群の間に放散により形成 された第2級飲体群(拡散紙飲体幹)と前記ポリ シリコン級飲体と前記試散抵抗体とも相互保証する電視とにより構成していた。